



Scan QR Code for product user guide

action
TESA[®]
KOI NAHI AISA



NEW VERSION 2 (JAN 2024)

BOILO - BWP HDF BOARD

USER GUIDE - उपयोग पुस्तिका



TESA ^{action}
KOI NAHI AISA®

प्रिय उपभोक्ता,

एक्शन ग्रुप जोकि पिछले 50 सालों से अपने उत्पाद की गुणवत्ता के लिए प्रसिद है। अब वह कारपेन्टर भाईयों व फर्नीचर बनाने के लिए बहुत ही बढ़ीया व सर्वोत्तम क्वालिटी के **Boilo - BWP HDF Board** बेस उत्पाद लेकर आए हैं। जिसका प्रयोग बहुत ही सरल व आसान है। यह उत्पाद अत्याधुनिक और पर्यावरण अनुकूल हैं। इनको प्रयोग करने मे आपका समय भी बहुत कम लगेगा और आपकी कड़ी मेहनत को देगा जबर्दस्त निखार। टेसा **Boilo - BWP HDF Board** से आप रेस्टरूम टॉइलेट क्यूबीकल, थरमल इन्सूलेशन, लोड बैरिंग एरिया – डैकिंग /माल गोदाम रैक फर्नीचर/सीढ़िया, कन्टेनर/बस/ट्रक फर्श, बाथरूम पार्टिशन, अग्नि रोधक प्रयोग, फर्श व दिवार पैनलिंग, फर्नीचर दरवाजे, पार्टिशन, मोडूलर किचन, अलमारी, स्टेज एवं स्पोर्टस फर्श, ईट भट्टा इत्यादि, आप जो भी बनाना चाहेंगे आसानी और मजबूती से बना लेंगे।

टेसा के उत्पादों की शानदार रेंज से आप और आपके ग्राहक रहेंगे हरदम संतुष्ट। टेसा की ओर से प्रस्तुत यह पुस्तिका इस दिशा में एक अहम कदम है। निरंतर प्रगति के लिए हमें आपकी राय की हमेशा जरूरत रहेगी जिससे की हम आपकी और बेहतर सेवा कर सकें। पुस्तिका के बारे में अपने सुझाव/विचार हमें अवश्य भेजें।

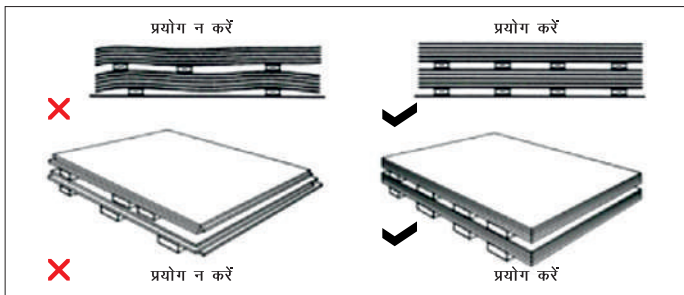
आपकी आभारी,

एक्शन टेसा

भंडारण

1. स्टैकड पैनलों के किनारों को ऊपरी किनारों या कोनों के ऊपर चढ़कर व्यवस्थित रखें ताकि टककर से किनारों और कोनों को क्षतिग्रस्त से बचाया जा सके।
2. बोर्ड को न तो सरकाएं, न ही घसीटें तथा न ही गिराएँ।
3. फर्श पर बिखरे कील इत्यादि नुकीली वस्तुएँ साफ कर दें।
4. भंडारण क्षेत्र साफ तथा सुखा होना चाहिए और हवादार होना चाहिए। 50% की औसत सापेक्षिक आर्द्रता (average relative humidity) पैनलों में 7 से 9% की नमी सामग्री सुनिश्चित करता है।
5. जहां परिवहन, अस्थायी भंडारण या साइट पर बेहद नम या बेहद शुष्क स्थितियां हो वहां पैनल्स को प्लास्टिक के पन्नी में लपेटें।
6. पैकिंग पेपर को बोर्ड का उपयोग करने से पहले ही निकालें तथा सुरक्षात्मक BOPP फिल्म बोर्ड उपयोग करने के बाद हटा दें।
7. Boilo - BWP HDF Board पैनलों को पैक में, क्षैतिज (Horizontal) रूप से पैलेट पर या स्टैकड बीम (70 x 70 or 90mm x 90mm) पर क्षैतिज रूप में रखा जाता है। नम Palets पर पैनलों को रखने से पहले एक पॉलीथीन पन्नी को रखा जाना चाहिए।
8. Boilo - BWP HDF Board में विक्षेपण (wrap) को रोकने के लिए, स्टैकड बीम एक दूसरे के उपर रखें।
9. लंबे समय तक भंडारण अवधि के दौरान अलग-अलग परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों को सीमित करने के लिए लॉट के उपर एक या दो स्क्रेप पैनल रखें।
10. स्टैकड पैनलो को खुले खिडकी / दरवाजों से दूर रखें।

सही भंडारण के लिए चित्र संख्या 1 का अनुसरण करें।



चित्र 1

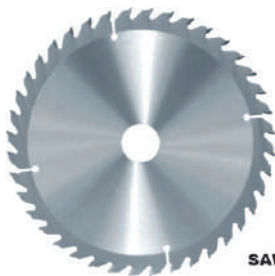
1. स्टैकड बीम का उपयोग करते समय ध्यान दें कि वे बराबर मोटाई के हों, और 800 एम.एम. से अधिक दूर न हों। 15 मि.मी. से कम मोटी Boilo - BWP HDF Board के लिए स्टैकड बीम का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। बोर्ड मोटाई के 50 गुना अंतराल (gap) पर बीम रखें (तालिका 1 देखें)। पैन्लों के पक्ष बाहरी स्टैकड बीम से 200 मि मी से ज्यादा निकली न हो।

Panel thickness (mm)	Spacing between beams (m)	Panel length (mm)	Min. number of beams per pallet
6	0,3	2500	8
8	0,4	2500	6
10	0,5	2500	5
12	0,6	2500	4

तालिका 1

कटाई

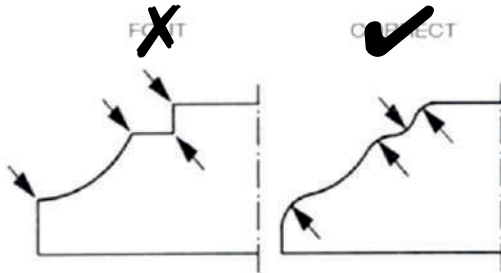
1. बोर्ड को बेहतर तरीके से काटने के लिए पैनल सॉ उपकरण या कोई हाथ द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई नामी कम्पनी का उपकरण जिसकी मोटर क्षमता 5000 RPM - 7000 RPM के बीच हो, प्रयोग में लाएं।
2. बोर्ड को काटने के दौरान, बोर्ड को सपाट सतह पर रखें तथा सुनिश्चित करें कि बोर्ड पर पकड़ मजबूत हो तथा बोर्ड को काटने के दौरान, इस्तेमाल किए गए ब्लैड की दिशा, मशीन पर चिनहित बोर्ड की दिशा के अनुरूप हो।
3. अधिक बोर्ड काटने की स्थिति में TCT Saw Blade का इस्तेमाल करें।
4. प्री-लेमिनेटेड बोर्ड काटते समय सुनिश्चित करे की बोर्ड के निचली सतह पर 6mm का स्क्रैप बोर्ड का इस्तेमाल करे तथा इस्तेमाल ब्लैड भी तेजधार हो जिससे बोर्ड में चिपिंग को रोका जा सके।
5. हेन्ड कटर द्वारा फीडिंग स्पीड जो टेसा द्वारा सुझाई जाती है :
12mm बोर्ड काटने के लिए 10–12 second per mtr
18mm बोर्ड काटने के लिए 22–25 second per mtr



**TCT
SAW BLADE**

प्रोफाइलिंग तथा ड्रिलिंग

1. Boilo - BWP HDF Board प्रोफाइलिंग के लिए सर्वोत्तम है।
2. कठोर और तेज प्रोफाइल के लिए हार्ड मेटल (एचएम) टूल्स का उपयोग करें।
3. लंबे समय के लिए, पॉलीक्रिस्टेलिन हीरा (पीसीडी) काटने के उपयोग करने की सिफारिश की जाती है क्योंकि यह पारंपरिक उपकरण की तुलना में 50 से 60 गुणा अधिक काम करता है।
4. अच्छे परिणामों के लिए हमेशा तेज़ धार वाले औजारों का प्रयोग करें।
5. नुकीले प्रोफाइल की अपेक्षा घुमावदार किनारों को अधिक पसंद किया जाता है।
6. जहां प्रभावों (उदाहरण के लिए रसोई के दरवाजे) से क्षति का खतरा होता है, 3 मिमी की न्यूनतम त्रिज्या की सिफारिश की जाती है।
7. थोड़ा घुमावदार वाले किनारों को पेंट या वार्निश के साथ बेहतर लेपित किया जा सकता है और इसमें अत्यधिक रोधक क्षमता होती है।





1. Boilo - BWP HDF Board पैनलों की ड्रिलिंग के लिए 3500 आरपीएम की गति की सिफारिश की जाती है।
2. पीछे की तरफ Boilo - BWP HDF Board पैनलों को फटने से रोकने के लिए, पैनल के दोनों तरफ आधी गहराई के छिद्र करने की सिफारिश की जाती है।
3. विशेष ध्यान रखें कि छेद के दोनों हिस्सों को पूरी तरह सीधी रेखा में ड्रिल करें।

औजार

1. हार्ड मेटल कटर के उपयोग का सुझाव दिया जाता है क्योंकि वे बेहतर **surface finish** देते हैं और लंबे समय तक काम करते हैं।
2. डिस्पोजेबल कटर बेहतर तकनीकी प्रदर्शन करते हैं, परंतु नाजुक होती है। मशीनों के सीमित डाउनटाइम सही प्रोफाइलिंग और कटर का स्थिर व्यास (कोई **adjustment** आवश्यक नहीं) के कारण डिस्पोजेबल कटर का उपयोग लागत प्रभावी है। कटर या तो घुमाया जा सकता है या बदला जा सकता है, जबकि औजार मशीन पर ही रहता है।
3. लंबे समय के लिए, पॉलीक्रिस्टेलिन हीरा (पीसीडी) काटने के उपकरण उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

सैंडिंग बेल्ट

1. सैंडिंग बेल्ट सरल प्रोफाइल आकृतियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
2. दो चरणों में सैंडिंग द्वारा एक उत्कृष्ट फिनिश प्राप्त किया जाता है। पहले 80 ग्रिट के साथ फीड दिशा के विपरीत और फिर 120 ग्रिट के साथ फीड दिशा में।
3. पैनल की सतह को 150 से कम grit size के सैंडिंग बेल्ट से महीन सैंडिंग कर सकते हैं उदाहरणार्थ Boilo - BWP HDF Board सतहों पर lacquering के लिए।
4. सैंडिंग बेल्ट का लाभ यह है कि वे घर्षण द्वारा कम तापमान उत्पन्न की वजह से लंबे समय तक चलते हैं। सैंडिंग बेल्ट जटिल प्रोफाइल के लिए कम अनुकूल हैं।

सैंडिंग ब्रश

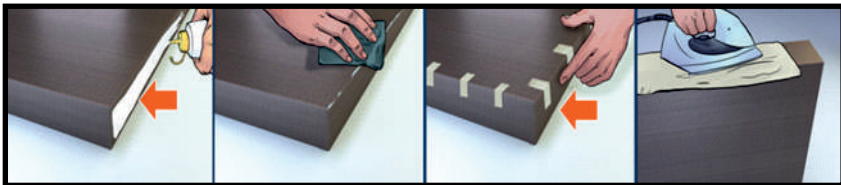
सैंडिंग ब्रश को मैनुअल मशीन पर भी स्थापित किया जा सकता है।

वे गहरे और संकीर्ण प्रोफाइल के लिए उपयुक्त है।

ब्रश व्यास अनुसार 3000 आरपीएम तक की सलाह दी जाती है।

एड्ज बैंडिंग

1. एड्ज बैंडिंग के लिए कृपया पीवीसी टेप का उपयोग करें।
2. Boilo - BWP HDF Board पर एड्ज बैंड चिपकाने के लिए हॉटमैल्ट गोंद या PUR गोंद का प्रयोग करें।
3. Boilo - BWP HDF Board के एक किनारे पर गोंद लागू करें और स्प्रेडर/चाकू/रंग की मदद से एकदम समान रूप से गोंद को फैलाएं।
4. एड्ज बैंड एकसमान दाब प्रयोग कर संयुक्त हिस्से से अतिरिक्त गोंद बाहर निकालें। कपड़े/कपास का सावधानीपूर्वक प्रयोग करके अतिरिक्त गोंद पोंछ दें।
5. एड्ज बैंड को हाथ से दबाव से 2-5 मिनट दबाएं, जोड़ की मजबूती रखने के लिए मास्किंग टेप का उपयोग करें।
6. मजबूत जोड़ 4-6 घंटे में प्राप्त की जाती है। उत्कृष्ट जोड़ सामान्य तापमान पर 24 घंटे में प्राप्त किया जा सकता है।
7. 1 घंटे के भीतर तेज़ी से काम करने के लिए, मोटी सूती कपड़े से किनारों को लपेटें और 1 मिनट के लिए गरम आइरन करें और कृपया इस प्रक्रिया को चार से पांच बार दोहराएँ।



पेंच (स्कू) कसना

Boilo - BWP HDF Board के लिए स्कू का उपयोग करने के तरीके के कुछ सबसे महत्वपूर्ण दिशानिर्देश यहां दिए गए हैं। TESA Boilo - BWP HDF Board आपको फेंस और एड्ज पर बेहतरीन screw pull out (screw holding) स्कू रोधक क्षमता प्रदान करता है।

ड्रिल बिट का व्यास : आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि छेद ड्रिल का व्यास स्कू व्यास की तुलना में थोड़ा छोटा है।

पाइलट छिद्र का व्यास : आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपके ड्रिल के छेद Boilo - BWP HDF Board स्कू व्यास का 85 प्रतिशत है।

ड्रिल बिट की लम्बाई : आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपके ड्रिल बिट की लम्बाई स्कू की लम्बाई से ज्यादा हो।

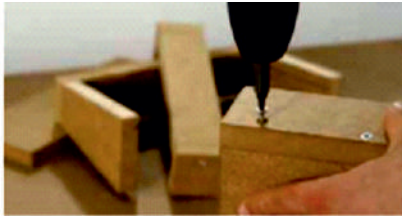
पाइलट छिद्र की लम्बाई : आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपके ड्रिल स्कू की लंबाई थोड़ी ज्यादा गहरी है। उदाहरण के लिए, छिद्रों को स्कू की गहराई से लगभग 2 से 3 मि.मी. ज्यादा गहरा तक ड्रिल किया जाना चाहिए।

सुनिश्चित करे स्कू किनारे से कम से कम 1.5 इंच दूर रहें : यदि आप सीधे Boilo - BWP HDF Board के फेंस पर स्कू कसना चाहते हैं तो स्कू किनारों से कम से कम 1.5 इंच की दूरी पर रखने की कोशिश करें और कोने से 35 मिमी से कम दूरी न रखें।

सुनिश्चित करे स्कू अंत (अंतिम छोर) से कम से कम 2.5 इंच दूर रहें : यदि आप बोर्ड के किनारों पर स्कू कस रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि स्कू अंत (अंतिम छोर) से कम से कम 2.50 इंच दूर हैं। यथासंभव सटीक व सटीक होने की कोशिश करें।

इसे अत्यधिक न कसें : बोर्डों में पेंच धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक कसें। अत्यधिक न कसें। अत्यधिक कसने के दौरान बोर्डों में दरार पड़ सकती है। आप सेल्फ-टैपिंग स्कू का प्रयोग भी कर सकते हैं।

Ø (mm) Screw	Ø (mm) Shaft	Ø (mm) Drilled Hole
3.0	2.2	2.0
3.5	2.8	2.5
4.0	3.1	3.0
4.5	3.6	3.5
5.0	4.2	4.0



Full
Threaded Screw



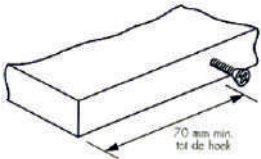
\varnothing mm screw
 \varnothing (mm) shift
 \varnothing (mm) Drilled Hole



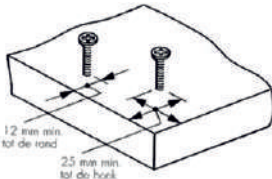
SCHROEFEN VAN DUNNE STAAK



SCHROEFEN VAN DUNNE STAAK



70 mm min.
tot de hoek



12 mm min.
tot de rand
25 mm min.
tot de hoek



Self Tapping
Screw



ध्यान दें : कील का प्रयोग निशिद्ध/वर्जित है। स्कू पर हथोड़े का इस्तेमाल न करें।
पूर्ण थ्रेडेड स्कू का उपयोग करें।

ज्वाइनवरी फिटिंग

सामान्य तौर पर बाजार में उपलब्ध ज्वाइनरी फिटिंग का उपयोग

TESA Boilo - BWP HDF Board में बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।



ब्लॉक कनेक्टर



शेल्फ क्लिप



मिनी फिक्स



ऑटो हिन्ज



बेड क्लैम्प



एल पत्ती (Clamp)



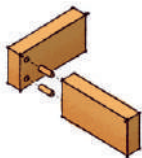
राइट एंगल ब्लॉक



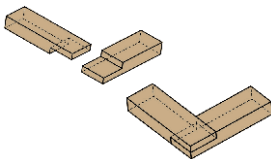
स्कू जाइंट

जोड़

1. TESA Boilo - BWP HDF Board सामान्य तरीके से जोड़े जा सकते हैं।
2. किनारों के स्तर समतल और चौकोर होने चाहिए।



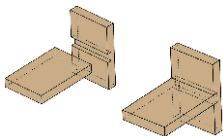
डॉवेल जोड़



हाफ लैप जोड़



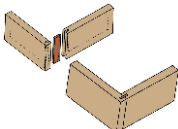
रैबैट जोड़



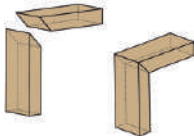
डेडो जोड़



टंग एंड ग्रूव जोड़



स्पलाईन जोड़



माइटर जोड़

पेंट तथा पॉलिश

1. Boilo - BWP HDF Board सतहों को साफ व धूल मुक्त होना चाहिए। किसी भी धूल या दाग को वायर ब्रूस या रेगमाल स्क्रेपर की मदद से हटाया जाना चाहिए।
2. Boilo - BWP HDF Board पैनल को पेंट करने से पहले condition कर लें। पेंटिंग की प्रक्रिया उसी जलवायु परिस्थितियों में करें जिसमें Boilo - BWP HDF Board का इस्तेमाल होना है।
3. भरने या मरम्मत करने के बाद, सतह को चिकना करने और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए रेगमाल (ग्रीट (grit) >पी 220) के साथ घिसाई करें। सतह के sanding के बाद धूल को साफ किया जाना चाहिए।
4. एक सफेद, कम गंध वाली, इन्सुलेटिंग रंग से प्राइमर कोटिंग करें।
5. इन्सुलेट प्राइमर कोट, टॉप कोट्स के असमान अवशोषण, संभव दाग या रंग की अनियमितता को रोकता है।
6. किसी भी क्षति की मरम्मत के लिए प्यूटी का उपयोग करें।
7. सतह को रेगमाल (ग्रीट पी 180—पी 220) द्वारा हल्के से घिसाई करें। घिसाई के बाद धूल को साफ किया जाना चाहिए।
8. टॉप कोट के लिए निम्नलिखित पेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है :
वाटर –सॉल्वेंट रंग (PU पीयू– साटन और हाइड्रोसिल्क पेंट)
वाल पेंट या वाटर –सॉल्वेंट रंग (लेटेक्स पेंट, एक्रिल पेंट या विनाइल पेंट) और कृत्रिम रंग
9. एक अच्छी तरह से कवर कोटिंग प्राप्त करने के लिए, कम से कम दो टॉप कोट की सिफारिश की जाती है।
10. बोर्ड की सतह एवं एडजस को खुला न छोड़े उसपर पेंट करें अथवा लेमिनेट या एडज बेन्ड अवश्य चिपकाएँ।
11. बेंडिंग की समस्या से बचने के लिए यह सुनिश्चित करे कि बोर्ड के दोनों तरफ एक समान (थीकनेस) कोटिंग या माइका का प्रयोग किया हो।
12. OSR Boilo बोर्ड में वारपेज की समस्या से बचने के लिए केवल 16MM और उससे अधिक मोटई का बोर्ड का प्रयोग करें

TESA Boilo - BWP HDF Board खासियत

TESA Boilo - BWP HDF Board की सतह बहुत चिकनी होने की वजह से पेंटिंग के लिए सर्वोत्तम सतह।

पेंट की खपत आम बोर्ड की तुलना में 25 प्रतिशत कम होती है।

विनअर पेस्टिंग (चिपकाने) के लिए सर्वश्रेष्ठ सतह।

कट

TESA Boilo - BWP HDF Board की सतह बहुत चिकनी है और सतह घनत्व अधिक होने की वजह से यह एनग्रेविंग (नक्काशी) जाली कटाई के लिए सबसे उपयुक्त बोर्ड है।

आप सजावटी किनारों को बनाने के लिए एक राउटिंग का उपयोग कर सकते हैं।

वॉल पैनेलिंग

दीवार पैनेलिंग के लिए एक छोटी लेकिन उपयोगी दिशानिर्देश नीचे दिया गया है:

- दीवार पैनेलिंग के लिए न्यूनतम 12mm या उससे अधिक मोटे बोर्ड का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। (8mm मोटाई से कम का बोर्ड उपयोग न करें)
- पैनेल को कमरे की स्थिति/स्थनीय जलवायु की स्थिति में रखें, प्रत्येक पैनेल रूप को लंबे किनारे के सहारे लंबवत खड़े करें या उन्हें सपाट बिछाएं और उनके बीच लकड़ी की छड़ों के साथ रखें ताकि हवा प्रत्येक पैनेल के चारों ओर कम से कम 48 घंटे तक घूमती रहें।
- बोर्ड को अधिक समय तक धूल/नम स्थिति में नहीं रखें, दूसरे शब्दों में, बोर्डों के धूल संचय से बचें, क्योंकि धूल नमी को सोखकर और संरक्षित कर लेगा जिसके कारण फंगस लगने की संभावना रहेगी।
- मौजूदा दीवार में सूखेपन की जांच करें, यह किसी भी प्रकार की नमी से मुक्त होना चाहिए।
- वॉल पैनेलिंग के लिए शीट को 4ft x 4ft या 2ft x 8ft में काटकर इस्तेमाल करें तथा 2MM से 3MM का गैप सुनिश्चित करें। Boilo - BWP HDF Board एक प्राकृतिक लकड़ी से बना एक पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद है, जो प्रकृति में सजातीय है, इसमें मामूली विस्तार और सिकुड़न के गुण हैं।
- विश्व स्तर पर दीवार पैनेलिंग 200 से 300mm चौड़ा पैनेल पर टंग और ग्रूव प्रोफाइलिंग के द्वारा किया जाता है। दीवार पैनेल में जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले मामूली विस्तार और सिकुड़न के लिए टंग और ग्रूव में गैप रखा जाता है। हालांकि जंहा दीवार पैनेल में टंग और ग्रूव प्रयुक्त नहीं किया जाता, वहाँ विस्तार और सिकुड़न को एडजस्ट करने लिए प्रावधान करें
- सुनिश्चित करें की Boilo - BWP HDF Board की सतह दीवार के सीधे संपर्क में न हो। बाहरी दिवार के अन्दरूनी तरफ पैनेलिंग करते समय फोम या प्लास्टिक अथवा मैटल फ्रेम का इस्तेमाल करें। जिससे पानी व नमी से बोर्ड को बचाया जा सकें।

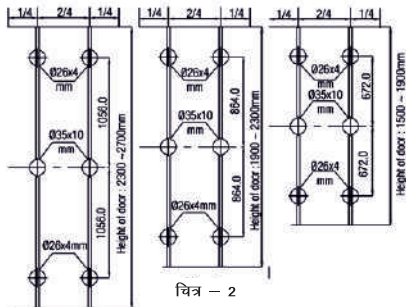
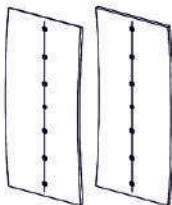
- धातु की फ्रेम या भट्टी की सूखी लकड़ी 1" x 2" का उपयोग लकड़ी के ग्रिड के रूप में बोर्ड (ग्रिड आकार 12" x 12" या 16" x 16") लगाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि दीवार की सतह एक समान नहीं हो सकती है, और आप लकड़ी के ग्रिड का उपयोग शीर्ष सतह को समान करने में मदद मिलेगी और यह बोर्डों को दीवार की नमी से बचाएगा।
- अधिक सुरक्षा के लिए, लकड़ी के ग्रिड और दीवार के बीच न्यूनतम 80 माइक्रोन की पॉलिथीन शीट का उपयोग किया जा सकता है।
- पैनलिंग को दीवार के कोने से शुरू किया जाना चाहिए, और कोनों पर बोर्ड के लंबवत विस्तार को एडजस्ट करने के लिए प्रावधान रखा जाना चाहिए।
- बोर्ड को ग्रिड पर चिपकाया अथवा स्क्रू मदद से फिट किया जा सकता है। 400 मिमी से अधिक चौड़े पैनल के लिए धातु के कैंचर उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
- बोर्ड की आंतरिक सतह को पेंट/पॉलिश द्वारा सील किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए सतह के दोनों ओर पेंट अथवा पॉलिश/माईका कि परत/मोटाई समान होनी चाहिए। ऐसा न करने से वारपेज/बैंडिंग कि संभावना बनी रह सकती है।
- दीवार पैनलिंग की अधिक स्थिरता के लिए पैनल की अनुशंसित चौड़ाई 12" या 16" होनी चाहिए। पैनल के बीच का अंतर 3-4 मि.मी भी बनाए रखें। बड़े क्षेत्रफल के पैनलिंग के लिए पैनल के बीच का अंतर समान अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए, तथा पैनल का अधिकतम आकार 3' x 3' होना चाहिए।
- सिफारिश की जाती है की ग्रिड पर वहाँ पेंट करें जहां आप दो पैनल जोड़ेगे, सुनिश्चित करें कि पेंट का रंग पैनलों के रंग से मेल खाता हो। ऐसा करने से जोड़ कम दिखाई देगा।
- सिफारिश की जाती है की पैनल के बीच का अंतर (गैप) को न सील करें और न ही भरें। यदि आप पैनल के बीच का अंतर (गैप) को सील अथवा भरना चाहते हैं तो कृपया केवल सिलिकॉन सीलेंट का उपयोग करें क्योंकि यह विस्तार और सिकुड़न का एडजस्ट कर सकता है। पैनल के बीच का अंतर (गैप) को किसी भी ठोस पट्टी से सील नहीं करना चाहिए।
- BIS मानक के अनुसार एम.डी.एफ. में 2mm प्रति मीटर वारपेज (बैंडिंग) मान्य है तथा यह Boilo - BWP HDF Board पर भी मान्य है।

पैनल वारपेज से कैसे बचें

डोर स्टिफनर / डोर स्ट्रेटनर

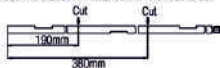
- 1 डोर स्टिफनर को दरवाजे की उचाई के अनुरूप काट लें। चित्र 1 देखें।
- 2 दरवाजे की चौड़ाई 600 mm से अधिक होने पर 2 सेट डोर स्टिफनर का प्रयोग करें।
- 3 चित्र 2 में दर्शाए गए दरवाजे में गोल केविटीज को काटें।
- 4 जैसा कि चित्र 3 में दर्शाया गया है Ø26mm केविटी को जोड़ते हुए Ø3.5mm x 11mm गहरा एक राउटर काटें।
- 5 लैथ एडजेस्टर का इस्तेमाल करते हुए दोनों रोड्स को जोड़ें।
- 6 दिए गए सेल्फ-टैपिंग स्क्रू से शटर पर असैम्बली को फिट करें।
- 7 सेल्फ-टैपिंग स्क्रू का प्रयोग करते हुए उचित दूरी पर कवर प्लेट्स फिट करें।
- 8 सेंटर कवर को ठीक इस तरह से फिट करें कि सेंटर प्लेट का दरवाजे को खुलते समय लैथ एडजेस्टर पर होल्स साफ तौर पर दिखाई दे सकें।
- 9 जैसा कि चित्र 4 में दर्शाया गया है चाभी का इस्तेमाल छेद करते हुए लैथ एडजेस्टर को घुमाकर शटर में बैंड को एडजेस्ट करें।
- 10 OSR बोर्ड के लिए, कार्य करने के समय BOPP Film को हटा दें (पेंट, डिको, लैमिनेट, विनियर व अन्य कार्य के लिए) ऐसा करने पर हम वॉरपेज और अन्य सरफेस की समस्याओं से बच सकते हैं।
- 11 BSB/OSL बोर्ड के लिए, कार्य करने के उपरांत BOPP Film को हटा दें, ऐसा करने पर हम वॉरपेज और अन्य सरफेस की समस्याओं से बच सकते हैं।

नोट: 4 फीट से अधिक उंची शटर अथवा दरवाजों के लिए डोर स्टिफनर का इस्तेमाल अवश्य करें।

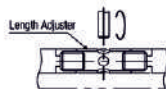


चित्र - 2

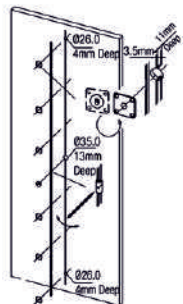
Door from 1500mm to 1900mm : cut 380mm
 Door from 1900mm to 2300mm : cut 190mm
 Door from 2300mm to 2700mm : No need to cut



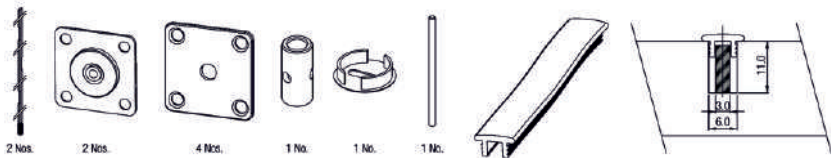
चित्र - 1



चित्र - 4



चित्र - 3



Door Stiffner

Cover For Door Stiffner

अच्छे नतीजे के लिए – टेसा बोर्ड पर माईका चिपकाने के निर्देश

1. उपयोग से पहले माइका, बोर्ड तथा गोंद को समान परिवेश में जलवायु अनुकूलन के लिए कम से कम 48 घंटे के लिए स्टोर करें।
2. माईका चिपकाने से पहले, सुनिश्चित करें कि सतह ठीक से समतल है और किसी भी तरह की गंदगी जैसे तेल, अतिरिक्त नमी और दूषित प्रदाथों से मुक्त है
3. दबाव अथवा तनाव द्वारा क्रैकिंग से बचने के लिए, कृपया सुसिन्क्षित करें कि कटे हुए बाहरी कोने तीखे और किनारें खुरदरे न हों।
4. अच्छी गुणवत्ता वाले गोंद का उपयोग करें। गोंद उपयोग करने से पहले अच्छी तरह मिलाएं।
5. गोंद में पानी मिलाने से बॉन्डिंग कमजोर होता है।
6. माईका तथा बोर्ड के मजबूत बॉन्डिंग के लिए सही मात्रा में गोंद उपयोग करें।
7. माईका तथा बोर्ड (Boilo - BWP HDF Board) की सतह पर ब्रश, कंघी प्रकार स्प्रेडर या पेंट रोलर की सहायता से गोंद की समान कोट लागू करें।
8. जब लगी हुई गोंद चिपचिपा हो जाएँ (आमतौर पर 5-10 मिनट के लिए, वायुमंडलीय स्थितियों पर निर्भर



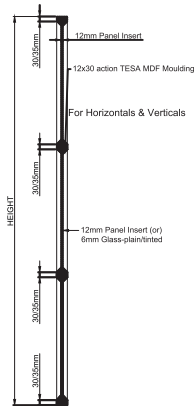
करता है) माईका को बोर्ड कि सतह पर सही ढंग से रखें तथा मजबूत बॉन्डिंग के लिए मजबूती से दबाव करें।

9. सनमाईका को बोर्ड की सतह पर रखते तथा दबाव के दौरान विशेष सावधानी रखें कि कहीं भी एयर बबल न बने।
10. संतोषजनक जोड़ के लिए माईका और बोर्ड पर दबाव 12—18 घंटे की अवधि के लिए रखें।
11. बरसात के मौसम में तथा अत्याधिक नमी वाले वातावरण में अच्छी जोड़ के लिए माईका और बोर्ड पर दबाव कम से कम 18 घंटे की अवधि के लिए रखें।
12. जब माईका को लंबवत चिपकाया जाना है, तो गोंद सूखने तक सभी ओर (साईड) दबाव बनाए रखें।
13. लंबवत प्रयोग के लिए अधिकतम साईज 610x2400 रखें। बड़े आकार के लिए चिपकाने कि प्रकिया वर्क शॉप में करें।
14. माईका चिपकाने के समय इस बात का ध्यान रखें की बोर्ड पर सीधी सूरज की रोशनी न आए,
15. *OSR Boilo* बोर्ड में वारपेज की समस्या से बचने के लिए केवल 16MM और उससे अधिक मोटई का बोर्ड का प्रयोग करें तथा रॉ साइड की **BOPP Film** को कटींग से पहले नही उतारें केवल **BOPP Film** को काम करने के समय में उतारें।

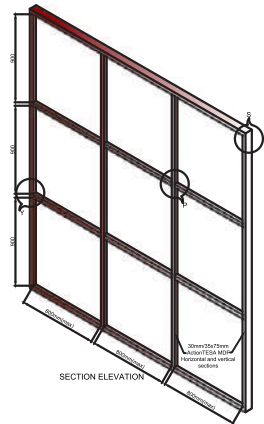
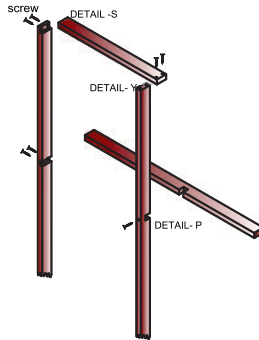
भवन और निर्माण अनुप्रयोगों

TESA Boilo - BWP HDF Board पार्टीशन, पैनलिंग, फ्लोरिंग, छत, इत्यादि के प्रयोग के लिए अनुकूल उप्तपाद है।

सिंगल स्किन पार्टीशन

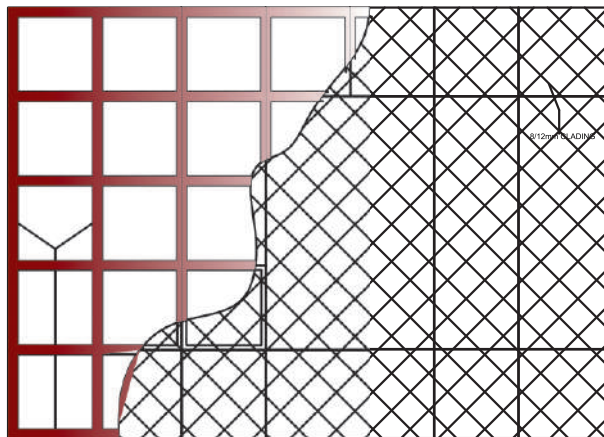


SIDE ELEVATION



SECTION ELEVATION

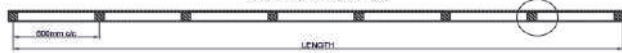
डबल स्किन पार्टीशन



30mm/35mmx65mm section TESA MDF
Horizontal and Vertical sections

EXPANSION GAP
3mm

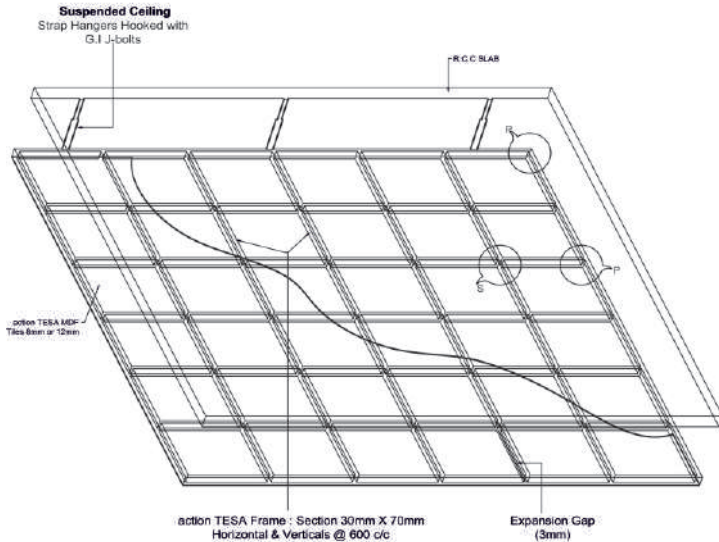
SECTIONAL ELEVATION



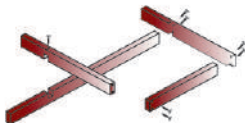
PLAN



DETAIL 'B'



SECTIONAL ELIVATION



DETAILS 'S' & 'P'



**TERMITE
PROOF**



**BORER
PROOF**



**FIRE
RETARDANT**



**FUNGAL
RESISTANCE**



**HIGHER
DENSITY**



**TOUGHER
THAN PLYWOOD**



**ENVIRONMENT
FRIENDLY**

FIRE RETARDANT

**TESTED AS PER STANDARD OF
FIRE RETARDANT PLYWOOD (IS 5509 : 2000)**

**FLAME RETARDANT 3 TIMES MORE AGAINST PASSING
PARAMETER OF IS 5509 : 2000 - FIRE RETARDANT PLYWOOD**





BOILO - BWP HDF BOARD

USER GUIDE - English Version



TESA[®] **action**
K O I N A H I A I S A

Dear Consumer,

As you all aware that Action Group is known for manufacturing products meeting international quality standard. With an aim to enable the carpenters & contractors across PAN India in manufacturing innovative and best quality furniture, the company has come up with **Boilo - BWP HDF Board** under the brand name TESA. These products are environment friendly. Using TESA **Boilo - BWP HDF Board** will help you to make ready beautiful innovation furniture in shortest time. TESA **Boilo - BWP HDF Board** has wide applications viz.

- Restroom Toilet Cubicle
- Thermal Insulation
- Load Bearing Area – Decking / Warehouse Shelves/ Staircases
- Container Floor
- Truck Floor
- Bus Body Floor
- Bathroom Partition
- Fire Retardant Application
- Flooring
- Wall Paneling
- Furniture
- Fixtures
- Modular Kitchen
- Wardrobes
- Moist Area Furniture
- Stage Flooring
- Sports Flooring
- Fly Ash Brick Making and many more.

With the exotic wide range of TESA products you can keep your customers always satisfied. Presenting this booklet is an important step in this direction. We always look forward your valuable suggestions towards continual improvement in providing better service. Please send us your feedback regarding this booklet.

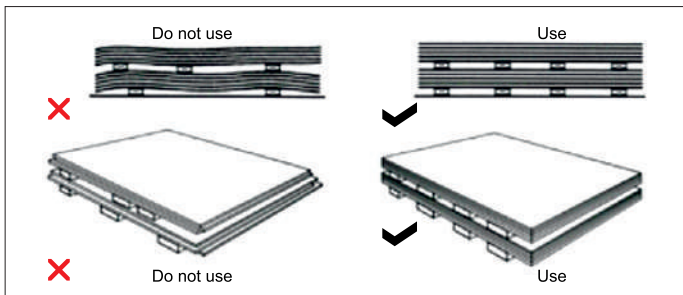
With Best Regards

Team TESA

Storage

1. The edges of stacked panels are aligned to prevent damage caused by bumping against overhanging edges or corners and discoloration due to sunlight.
2. Don't slide, push or drop the boards
3. Ensure the floor of storage area is clean and there are no nails, screws or any sharp items scattered.
4. The storage area must be dry and well ventilated. An average relative humidity of 50% ensures a moisture content of 7 to 9% in the panels.
5. Where extremely damp or extremely dry conditions may occur during transport, temporary storage or on site, the panels are wrapped in plastic foil.
6. Remove the packing paper before using the board and BOPP film should be removed after using the board.
7. Boilo - BWP HDF Board panels are best stacked horizontally in packs, preferably on pallets or on dry stacked beams (70 x 70 mm or 90 x 90 mm). On potentially damp substrates, a waterproof foil, e.g. polyethylene foil, is installed before the panels are stacked on it.
8. The stacked beams are placed on top of each other, in order to prevent warpage/deflection of the Boilo - BWP HDF Board.
9. To limit the adverse effects of varying ambient conditions, one or two scrap panels are placed on top of the stacks during processing or for prolonged storage periods.
10. Store stacked panels away from open doors & windows.

For proper storage refer Pic 1



Pic 1

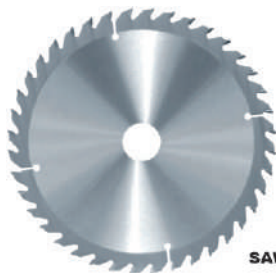
When using stacked beams, they must be of equal thickness and spaced no more than 800mm apart. For Boilo - BWP HDF Board less than 15mm thick, it is recommended to use stacked beams, e.g. spaced at intervals of 50 times the board thickness (see Table 1). The sides of the panels shall project no more than 200mm from the outer stacked beams.

Panel thickness (mm)	Spacing between beams (m)	Panel length (mm)	Min. number of beams per pallet
6	0,3	2500	8
8	0,4	2500	6
10	0,5	2500	5
12	0,6	2500	4

Table -1

Cutting

1. The ideal cutting equipment shall be a Panel Saw with a primary Cutting blade & a secondary scoring blade or Branded Hand-Held Circular Saw. The Cutting motor shall drive between 5000 RPM – 7000 RPM
2. During sawing, the Boilo - BWP HDF Board panel should be kept on perfectly leveled surface and the saw blade must be free of vibrations. Please also ensure that direction of Blade is same as per direction mark on machine.
3. For the processing of large Boilo - BWP HDF Board quantities, the use of TCT Saw Blade, in spite of the higher cost, be economically justified because of their longer working time (i.e. the time between regrinding of the tool).
4. To avoid chipping in prelaminated board, please use 6mm scrap board in bottom side at the time of cutting. And also ensure that saw blade should be sharp.
5. Cutting the board by Hand Cutter, TESA Recommended feeding speed is:
for 12 mm Board - 10-12 second per mtr.
for 18 mm Board - 22-25 second per mtr.

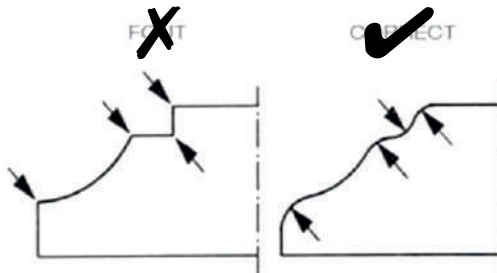


**TCT
SAW BLADE**

Note: - before using the Panels ensure to keep it at site for 48 to 72 Hours for conditioning.

Profiling and Drilling

1. TESA Boilo - BWP HDF Board are best suited for Profiling.
2. For rigid and sharp profiles, it is advised to use hard metal (HM) tools.
3. For large series, the use of polycrystalline diamond (PCD) cutting tools is recommended, as it allows a working time to be achieved that is 50 to 60 times that of conventional hard metal tools.
4. For best results always use sharpened tools
5. Simple profiles with curved edges are more preferred than sharp edges.
6. Where there is a risk of damage by impacts (e.g. kitchen doors), a minimum radius of 3mm is recommended.
7. The slightly radiused edges are better coated with paint or varnish and will therefore offer greater resistance to hard impacts.





1. For drilling Boilo - BWP HDF Board panels, standard drills and speeds of approx. 3500 r.p.m. are recommended, which allows high quality drilled holes with limited material accumulation on the rear side to be obtained.
2. To prevent material tearing on the rear side in case of drilled through holes, it is recommended to drill half of the hole depth on either side of the panel.
3. Special care should be taken to drill both holes halves in a perfectly straight line.

Tools

1. The use of hard metal cutters is recommended because they produce a better surface finish and have a longer working time.
2. Disposable cutters have better technical performance but the material is more brittle. The use of disposable cutters is cost-effective because of the limited downtime of the machines, the correct profiling, and the constant diameter of the cutter (no adjustment necessary). The cutter can either be turned around or replaced, whilst the tool itself remains on the machine.
3. For series production, increasing use is being made of polycrystalline diamond milling tools.

Sanding Belts

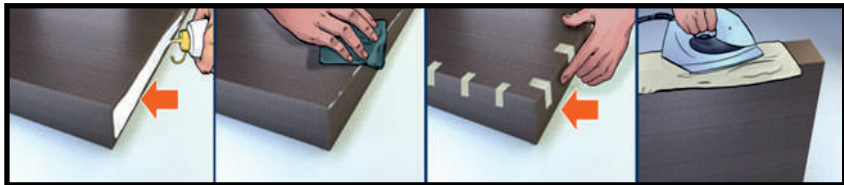
1. Sanding belts can be used for simple profile shapes.
2. A fine finish is obtained by sanding in two steps: first with grit 80 against the feed direction and then with grit 120 in the feed direction.
3. The panel surface can also be fine sanded using sanding belts with grit size less than 150, e.g. for lacquering Boilo - BWP HDF Board surfaces.
4. Sanding belts have the advantage that they last longer because a lower temperature is generated by the associated friction. Sanding belts are less suited for intricate profiles.

Sanding Brushes

1. Sanding brushes can be mounted both on manual machines and on a sanding facility of a production line.
2. They are efficient for deep and narrow profiles or for very wide milled recesses (several layers of brushes on top of each other).
3. The recommended speed can amount up to 3000 r.p.m., depending on the brush diameter.

Edge Banding

1. For edge banding use PVC tape only.
2. Use hot melt glue or PUR Glue for pasting edge band on Boilo - BWP HDF Board edges
3. Apply glue on one edge of the board and spread the glue uniformly on the edges with help of glue spreader/ knife etc.
4. Place the edge band on the edge and apply uniform pressure to ensure oozing out of excess glue from the joint portion, Remove the excess glue gently and carefully using cotton cloth.
5. Press the edge band joint for 2-5 minutes under hand pressure and then apply masking tape to hold the joint firmly.
6. Strong bond will be obtained within 4-6 hours and full bond strength can be achieved only after 24 Hrs at room temperature.
7. For finishing the work within 1 hour, wrap the edge with thick cotton cloth and apply hot iron for 1 minute and repeat the process 4-5 times.



Screws

Please find below useful and important tip regarding how to use screw on Boilo - BWP HDF Board offers excellent resistance to screw pull-out (screw-holding capacity), both in the face and on the edges.

Diameter of Drill Bit : Ensure that the diameter of drill bit is less than the diameter of screw.

Diameter of Pilot Hole : Ensure that the diameter of drill hole is 85% of than the diameter of screw.

Length of Drill : Ensure that the length of drill bit is more than the length of screw.

Length of Pilot Hole : Ensure that the length of drill hole is 2-3mm more than the length of screw.

Atleast 1.5 inch distance from Edge : While fastening screw directly on Boilo - BWP HDF Board face, ensure that a minimum distance of 1.5 inch to the panel edge and 35mm to the corners is maintained.

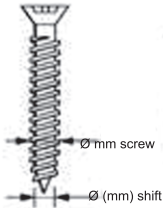
Atleast 2.5 inch distance from end : While fastening screw directly on Boilo - BWP HDF Board then, ensure that a minimum distance of 2.5 inch to corner/edge is maintained.

Don't over tighten : Tighten the screw slowly and steadily. Don't over tighten the screw. Over tightening may lead to crack in board. You can use Self Tapping Screw also.

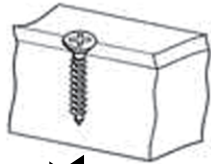
Ø (mm) Screw	Ø (mm) Shaft	Ø (mm) Drilled Hole
3.0	2.2	2.0
3.5	2.8	2.5
4.0	3.1	3.0
4.5	3.6	3.5
5.0	4.2	4.0



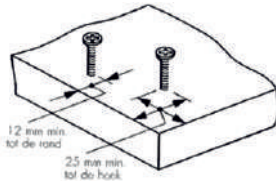
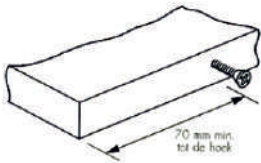
Full Threaded Screw



SCHROEFEN VAN DIT SOORT VERBODEN



SCHROEFEN VAN DIT SOORT TOEGestaan



Self Tapping Screw



Note : Use of nails is strictly prohibited. Never use hammer on screw.
Use full threaded screw

Joinery Fittings

Joinery Fittings commonly available in market can be used for joining
Boilo - BWP HDF Board



Block Connector



Shelf Clamp



Minifix



Auto Hinges



Bed Clamp



Clamp (L Patti)



Right Angle Block

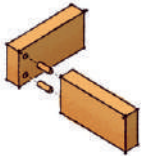


Screw Joints

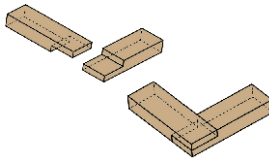
Joints

1.TESA Boilo - BWP HDF Board can be joined using simple technique.

2.The edges must be level and square.



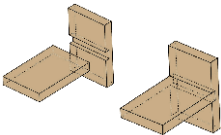
Dowel Joint



Half Lap Joint



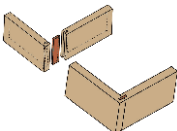
Rebate Joint



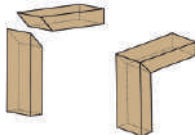
Dado Joint



Tongue and Groove Joint



Spline Joint



Miter Joint

Paint and Polish

1. The Boilo - BWP HDF Board surfaces must be clean and dust free. Any contaminations, e.g. fat or residual building products, must be removed.
2. The Boilo - BWP HDF Board panels are preferably conditioned before the paint finish is applied. Painting is carried out in more or less the same climatic conditions as those in which the Boilo - BWP HDF Board panels will effectively be used. In this way, cracks and stresses that might occur during strong temperature or moisture variations, can be avoided in the painted surface.
3. After filling and/or repair, the surface to be treated is preferably sanded with grit \geq P220 in order to obtain a smooth finish and good adhesion. After sanding the surface must be cleaned of dust.
4. A white, low odour, insulating, physically drying paint is preferably used for the primer coating.
5. The insulating primer coat prevents unequal absorption of the top coats and spreading of possible stains or colour irregularities from the substrate.
6. Any damages must be repaired with materials that are compatible with the subsequent paint system e.g. polyester filler.
7. Next the surface must be slightly sandpapered (grit P180-P220), while also making sure to neatly remove the sanding dust.
8. For the top coats the following paints can be used:
 - Solvent- or water-borne paint (e.g. PU-Satin and Hydrosilk from Boss Paints).
 - Wall paint, both water-borne paint (e.g. latex paint, acryl paint or vinyl paint) and synthetic paint.
9. To obtain a well-covering coating, at least two top coats are recommended.
10. Don't leave the Boilo - BWP HDF Board surface & edges bare, either paint it or paste laminate on it paste edge band on the edges.
11. To avoid warpage/bending problem, use same thickness of coating or laminate on the balancing side as well
12. **To avoid warpage/bending problem in OSR Boilo Board, use 16mm and above thickness only**

Specialty of TESA Boilo - BWP HDF Board

1. Super smooth surfaces, excellent for laminate/veneer pasting with zero bubble and paint/polish.
2. High Surface Density ensures 25% less consumption of paint/polish.

Engraving & Routing

TESA Boilo - BWP HDF Board has super smooth surfaces with high surface density which makes the boards best suitable for routing and engraving

Wall Paneling

1. To avoid bending problem in wall paneling always use panel size 4 feet X 4 feet or 2ft x 8ft and ensure to give 2-3mm gap between the panels.
2. Please ensure that bare board should not be in direct contact will the wall.
3. While paneling inner side of the exterior wall, use foam or frame of plastic/metal is recommended to avoid transfer of water/ moisture on the frame and the board.
4. As per ISI standard warpage/bending 2mm per meter is acceptable, its also applicable for Boilo - BWP HDF Board.

USAGE TIPS FOR (TESA BOARDS) - WALL PANELING

- Condition the panel to the room condition/ local climatic condition, stand them individually along the long edge or lay them flat with wood sticks spaced between them so that air circulates around each panel for at least 48 hours.
- Check existing wall condition for dryness, it should not have any type of dampness or moisture. , dampness must be repaired properly.
- Thickness of Boilo - BWP HDF Board recommended are 8mm or 12 mm.
- For partition up to 3000 mm, Kiln dried treated wooden frame to be used for the grid with section size of 65 mm x 30 mm with half lap joint and for height above 3000 mm and up to 4500 mm the section size should be 100 mm x 30 mm.
- The wooden frame and all unexposed area for the tile must be painted with 2 coats of primer paint. In case of any type of lamination, it must be ensured the thickness of the laminate is same on both front and back surface.
- Recommended tile size is 800 mm x 800 mm up to 3000 mm paneling and 900 mm x 900 mm for above 3000 mm paneling.
- A gap of 3-6 mm must be kept between the tiles.
- Screwing to be done at every 300 mm
- It is suggested to paint the grid where the panels will be joined, using color matching with the edges or grooves of the panel. This will make the joint less noticeable.
- The expansion gaps should not be sealed, however in case the gaps are filled, then the gap width to be increased to atleast 6 mm and the filling to be done by silicon sealant so that it will allow expansion and contraction. Never seal the gaps with any solid/ Hard filler.

Usage tips for Action Boilo - BWP HDF Board for Ceiling

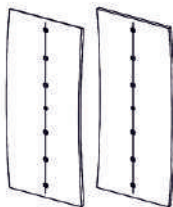
- Condition the panel to the room condition/ local climatic condition, stand them individually along the long edge or lay them flat with wood sticks spaced between them so that air circulates around each panel for at least 48 hours.
- Check existing wall condition for dryness, it should not have any type of dampness or moisture. , dampness must be repaired properly.
- Thickness of Boilo - BWP HDF Board recommended are 8 mm or 12 mm.
- Size of Boilo - BWP HDF Board for 8mm should not be more than 600 mm x 600 mm.
- A gap of 3 mm must be kept between the tile for tile size of 600 mm x 600 mm and 5 mm for tile size of 1200mm x 1200 mm.
- Kiln dried treated wooden frame to be used for the grid with section size of 65 mm x 30 mm with half lap joint.
- The wooden frame and all unexposed area for the tile must be painted with 2 coats of primer paint. In case of any type of lamination, it must be ensured the thickness of the laminate is same on both front and back surface.
- The wooden grid size should be 600 mm x 600 mm from center to center.
- Screwing to be done at every 300 mm
- It is suggested to paint the grid where the panels will be joined, using color matching with the edges or grooves of the panel. This will make the joint less noticeable.
- The expansion gaps should not be sealed, however in case the gaps are filled, then the gap width to be increased to atleast 6 mm and the filling to be done by silicon sealant so that it will allow expansion and contraction. Never seal the gaps with any solid/ Hard filler.

How to avoid Panel Warpage

Door Stiffner/Door Straightener

1. Cut the door stiffner strip to suit the height of the door as shown in Fig. 1
2. Use two set of door stiffner if width of door is more than 600mm
3. Cut the round cavities in door shown in Fig. 2
4. Cut a router of 3.5mm x 11 mm deep connecting the \varnothing 26mm cavity as shown in Fig. 3
5. Join the two rods using length adjuster
6. Fit the assembly on shutter using self tapping screws provided
7. Fit cover plates at appropriate distances using self tapping screws
8. Fit Center cover, access to the holes on length adjuster can be made through the oval slot in the center cover
9. Adjust the bend in shutter by relvolving the length adjuster by using the key as shown in Fig. 4
10. For OSR Board - Remove BOPP Film at the time of application (Paint, Deco, Laminate, Veneer & Other), So that we can avoid warpage & other surface problem
11. For BSB/OSL Board - Remove BOPP Film after application. So that we can avoid warpage & other surface problem

Note: - Door Stiffner is recommended for Door Panel height more than 4 Feet



Door from 1500mm to 1900mm : cut 380mm
 Door from 1900mm to 2300mm : cut 190mm
 Door from 2300mm to 2700mm : No need to cut

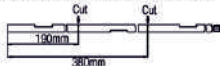


Fig. 1.

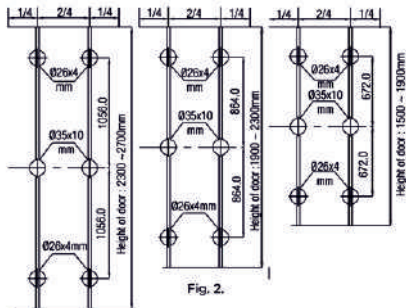


Fig. 2.

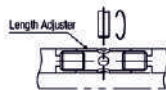


Fig. 4.

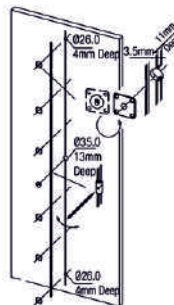
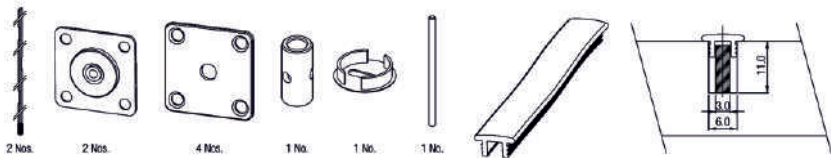


Fig. 3.



Door Stiffener

Cover For Door Stiffener

FOR BEST RESULT - PASTING OF MICA ON TESA BOARD

1. Store laminates, Substrates and Adhesive for at least 48 hours at the same ambient condition for acclimatization before use.
2. Before Pasting, ensure that the surface is properly levelled and is free from any kind of dirt like oil, grease, excess moisture and the contaminants.
3. To avoid stress cracking, avoid making cut outs having sharp corners and rough edges.
4. Use a good quality adhesive and stir well before use.
5. Adding water into the adhesive only makes the bonding weak.
6. Use accurate quantity of Adhesive on the Substrate (Boilo - BWP HDF Board) and laminate for good bonding
7. Apply an even coat of adhesive with the help of brush, comb type spreader or paint roller evenly on the surfaces of laminate and Substrate (Boilo - BWP HDF Board) that requires bonding.
8. Once the adhesive applied gets tacky in nature (Usually requires 5-10 minutes, depending on atmospheric conditions), the laminate need to



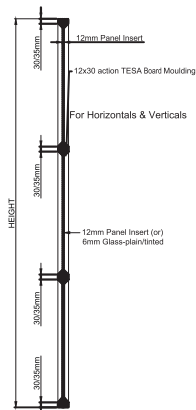
be placed on the surface, accurately aligned and pressed down firmly to ensure proper bonding.

9. Extreme care should be taken during alignment and pressing to guarantee an absence of air bubbles.
10. For satisfactory bonding, the area in question should be kept under pressure for a period of 12-18 hours (depending on atmospheric conditions).
11. In rainy season or when humidity is too high, keep bonded assembly for minimum 18 hours under pressure for good bonding.
12. When laminate is to be pasted vertically, maintain uniform pressure on all sides till adhesive is dried.
13. The size of vertical application should be limited to 610mmX2400mm. Larger sized bonded assemblies should be fabricated in the workshop to avoid bubbles.
14. Avoid direct sun light on board at the time of laminate pasting.
15. ***To avoid warpage/bending problem in OSR Boilo Board, use 16mm and above thickness only***

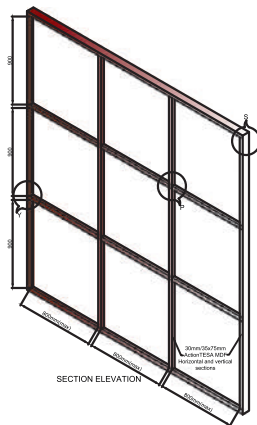
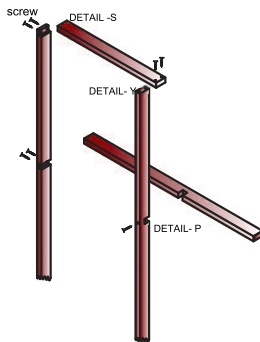
Building and Construction Applications

Action TESA Boilo is suitable for application such as partitions, panelling , flooring , ceiling etc. action TESA offers greater design flexibility to cater for varied requirements. for best results, specifications mentioned in the following diagrams should be referred for applications stated above.

SINGLE SKIN PARTITION

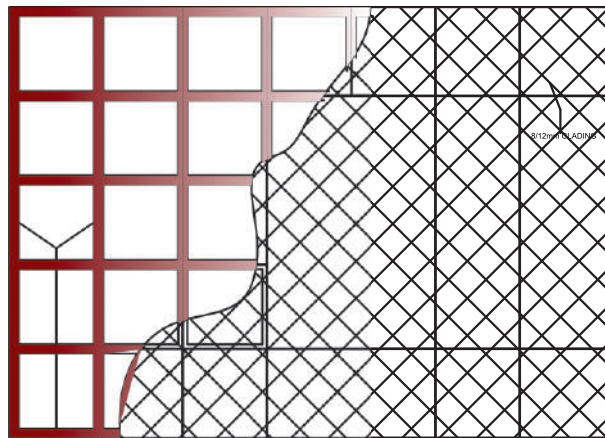


SIDE ELEVATION



SECTION ELEVATION

DOUBLE SKIN PARTITION



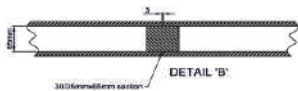
30mmx35mmx95mm action TESA Board
Horizontal and Vertical sections
@600mm c/c

EXPANSION GAP
30mm

SECTIONAL ELEVATION

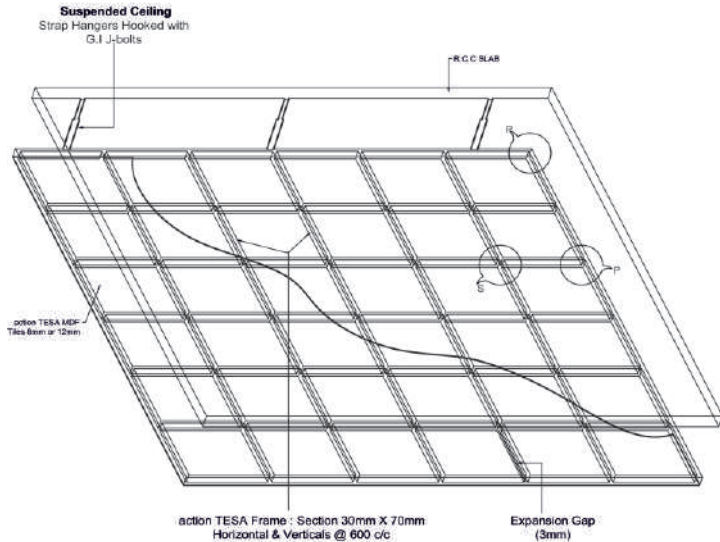


LENGTH
PLAN

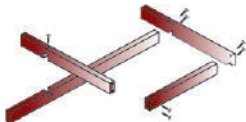


DETAIL 'B'

30x35mmx95mm section



SECTIONAL ELIVATION



DETAILS 'S' & 'P'



**TERMITE
PROOF**



**BORER
PROOF**



**FIRE
RETARDANT**



**FUNGAL
RESISTANCE**



**HIGHER
DENSITY**



**TOUGHER
THAN PLYWOOD**



**ENVIRONMENT
FRIENDLY**

FIRE RETARDANT

**TESTED AS PER STANDARD OF
FIRE RETARDANT PLYWOOD (IS 5509 : 2000)**

**FLAME RETARDANT 3 TIMES MORE AGAINST PASSING
PARAMETER OF IS 5509 : 2000 - FIRE RETARDANT PLYWOOD**



action
TESA[®]
KOI NAHI AISA

Balaji Action Buildwell Pvt. Ltd.



Regd. Office : G-11, Udhog Nagar, Peeragarhi,

New Rohtak Road, North West Delhi, Delhi - 110 041 **Ph.:** 011-41120000, 41120020

Plant : Plot No. C34, C34 (A) to (D) , C3, C6 (A) to (C), Eldeco SIDCUL Industrial Park, Sitarganj,

Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand - 262405



CUSTOMER CARE SERVICE: 1800 309 07 07
customerservices@actiontesa.com

www.actiontesa.com

